

PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
焊接工艺要求	MDC5K5	MDC5K5_CAP 焊接要求	V1	1/1	2025-12-02
<p>1. 元件均紧贴线路板焊接；</p> <p>2. 洗板后，线路板的表面不能有锡珠、锡渣等残留物；</p> <p>3. 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；</p> <p>4. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准</p>					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	